

成都高新投资集团有限公司

公司债券年度报告（2022年）

更正公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

成都高新投资集团有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日披露了《成都高新投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》，现对部分内容予以更正，具体内容如下：

一、“第四节 特定品种债券应当披露的其他事项”之“五、其他特定品种债券事项”

更正前：

无

更正后：

创新创业公司债券、科技创新公司债券募集资金使用情况：

1、20蓉高03

公司于2020年12月1日发行“成都高新投资集团有限公司公开发行2020年创新创业公司债券（面向专业投资者）（第一期）”，债券简称为“20蓉高03”，债券代码为175477.SH，发行总额为10亿元。根据募集说明书约定，20蓉高03募集资金使用计划如下：本期债券募集资金扣除发行费用后，不少于7亿元拟用于公司直接投资创新创业公司的股权，和/或用于置换前期公司直接投资于创新创业公司股权的投资资金；不超过3亿元用于偿还有息债务；如有剩余资金，则剩余部分用于补充流动资金。

截至2021年末，20蓉高03募集资金扣除发行费用后已按照约定使用完毕，

具体使用情况如下：

单位：万元

项目名称	行业领域	项目所处阶段	项目进展及促进创新发展效果	投资/使用金额
A 公司	先进电力设备	种子期	打造燃气轮机研发总部和制造基地（不包括零件生产能力建设），力争在 3 至 5 年内完成 40MW 燃机的自主生产。项目符合国家战略布局，是国家重大科技专项，有利于解决航空发动机领域“卡脖子”问题，提高关键领域自主创新能力。	30,000.00
B 公司	电子信息	成长期	打造自主品牌计算存储系列产品，为政务、金融、运营商、互联网、公安、交通等各行业数字化转型及发展提供自主可控、安全可靠超强算力支撑及销、研、产、供、服整体解决方案，深度参与全国各地信创项目，快速带动数字经济和算力产业发展。	3,000.00
C 公司	生物医药	成长期	新药上市申请获得受理。	3,000.00
D 公司	集成电路	初创期	公司专业从事 Micro-LED 自主研发、规模生产、市场销售，建有我国大陆首条具备 TFT 驱动背板、巨量转移、封装、模组等全工艺开发能力的 Micro-LED 中试产线，目前已成功突破了 Micro-LED 产业化关键技术。	33,000.00
E 基金	生物医药	-	已实现 1 个新药上市，1 个 NDA，3 个临床 III 期，8 个临床 II 期，12 个临床 I 期。管线丰富，产品梯度较好。	6,640.00
投资公司股权合计				75,640.00
偿还有息债务				24,234.10

2、21 蓉高 K1

公司于 2021 年 3 月 8 日发行“成都高新投资集团有限公司公开发行 2021 年科技创新公司债券（面向专业投资者）（第一期）”，债券简称为“21 蓉高 K1”，债券代码为 175835.SH，发行总额为 5 亿元。根据募集说明书约定，21 蓉高 K1 募集资金使用计划如下：本期债券募集资金扣除发行费用后，不少于 3.5 亿元拟用于公司直接或通过基金投资科技创新公司的股权，和/或用于置换前期公司直接或通过基金投资于科技创新公司股权的投资资金；不超过 1.5 亿元用于偿还有息债

务；如有剩余资金,剩余部分用于补充流动资金。

截至2022年末,21 蓉高 K1 募集资金扣除发行费用后已按照约定使用完毕,具体使用情况如下:

单位:万元

项目/基金名称	行业领域	项目所处阶段/基金备案类型	项目进展及促进创新发展效果/基金运作情况	投资/使用金额
公司股权投资				
A 公司	集成电路	初创期	公司专业从事 Micro-LED 自主研发、规模生产、市场销售,建有我国大陆首条具备 TFT 驱动背板、巨量转移、封装、模组等全工艺开发能力的 Micro-LED 中试产线,目前已成功突破了 Micro-LED 产业化关键技术。	4,925.11
B 公司	集成电路	成长期	公司先后被认定为工信部专精特新“小巨人”企业、四川省瞪羚企业、成都市行业“小巨人”企业,有助于带动高新区集成电路产业发展,增强成都半导体产业竞争力。	2,900.00
C 公司	微波射频器件	成长期	公司专门从事应用于电子对抗领域的微波收发产品的开发和研制的高新技术企业,有助于扶持成都本地高端装备产业龙头企业,带动微波射频产业发展。	2,756.00
D 公司	军用通信设备	成长期	公司专业从事无线电监测测向产品研制、生产、销售和技术服务的高新技术企业。	3,621.32
E 公司	集成电路	成长期	公司专注于模拟、射频及光电芯片研发、销售的高新技术企业。公司先后被评为国家重点集成电路设计企业、工信部第三批专精特新“小巨人”企业、2020 成都新经济百家重点培育企业、成都高新区瞪羚企业。	2,000.00
F 公司	信息系统集成服务	初创期	公司规划建设板级封装系统集成电路,结合扇外型、高密度与高带宽 SiP、板级封装三大技术优势,具备独家玻璃基板技术,采用大尺寸、高精度方形载板,单位效益更好,性能得到提升,确保产品高性价比市场竞争优势。	9,197.57
投资公司股权合计				25,400.00
基金投资				

G 基金	生物医 药	SNE977	基金已投部分项目已上市，部分项目已申报科创板。	9,600.00
基金投资合计				9,600.00
偿还有息债务				14,937.05

除上述内容更正外，《成都高新投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》的其他内容不变，本次更正对公司财务状况和经营结果、对公司的偿债能力和偿付安排不会造成影响，并在本更正公告发布的同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《成都高新投资集团有限公司公司债券年度报告（2022年）（更正）》，由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《成都高新投资集团有限公司公司债券年度报告
（2022年）更正公告》之盖章页）


成都高新投资集团有限公司
2023年7月18日